



En Lascas 2020 estudiantes e ingenieros compartieron alrededor de los temas de punta en el desarrollo de sistemas y circuitos. **Foto: Ruth Garita / OCM.**

Ingeniería Electrónica

## **Lascas 2020 rompió récord de participación en visita por Costa Rica**

28 de Febrero 2020 Por: Johan Umaña Venegas [1]

**En el evento participaron referentes en temas como 5G, Internet de las Cosas o Inteligencia Artificial**

**La actividad, coorganizada por el TEC, se realizó en Escazú, entre 25 y 28 de febrero**

**La edición de Lascas realizada en Costa Rica fue la más exitosa en cuanto a número de participantes y atracción de expositores líderes en la industria de tecnología**

de punta.

El **Simposio Latinoamericano de Circuitos y Sistemas** (Lascas, en inglés) [2] es la reunión más importante para la región del **Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica** [3] (conocido por sus siglas en inglés: IEEE) y celebró su edición número 11 en Escazú, entre el 25 y el 28 de febrero.

En esta ocasión el simposio latinoamericano estuvo coorganizado por el **Tecnológico de Costa Rica (TEC)** [4], el organización regional de la IEEE y la **Circuits and Systems Society** [5] (CAS).

“Es el Lascas con más participación en toda la historia, lo que nos pone muy orgullosos. Tenemos por primera vez, **además de la participación académica, una muy fuerte presencia de gente de la industria.** Hay mucha gente que vino de las empresas y esa es parte del objetivo del evento, hacer esa conexión entre la industria y la academia”, argumentó el Dr. Alfonso Chacón Rodríguez, docente del TEC y coorganizador del evento.

Entre los expositores se presentaron **referentes en tecnologías de avanzadas, como redes 5G, Internet de las Cosas o inteligencia artificial**, y los circuitos y sistemas que soportan esos importantes avances.

A su vez, participaron dignatarios de empresas líderes en la industria, como **Intel** [6], **Western Digital** [7] y **Hewlett Packard** [8], y académicos de prestigiosas universidades, entre ellas:



Vida Ilderem, vicepresidenta de Intel Labs, expone sobre el futuro de las redes de comunicación de quinta generación (5G). **Foto: Ruth Garita.**

- **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** [9], Estados Unidos.
- **Arizona State University** [10], Estados Unidos.
- **University of Pennsylvania** [11], Estados Unidos.
- **University of Maryland** [12], Estados Unidos.
- **Imperial College** [13], Reino Unido.
- **Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)** [14], Suiza.
- **Universidad de la República** [15], Uruguay.

- **Universidade Federal do Rio Grande do Sul** <sup>[16]</sup>, **Brazil.**
- **Nagoya University** <sup>[17]</sup>, **Japón.**
- **Carleton University** <sup>[18]</sup>, **Canadá.**

**“Creo que la colaboración entre la industria y la academia es extremadamente importante.**

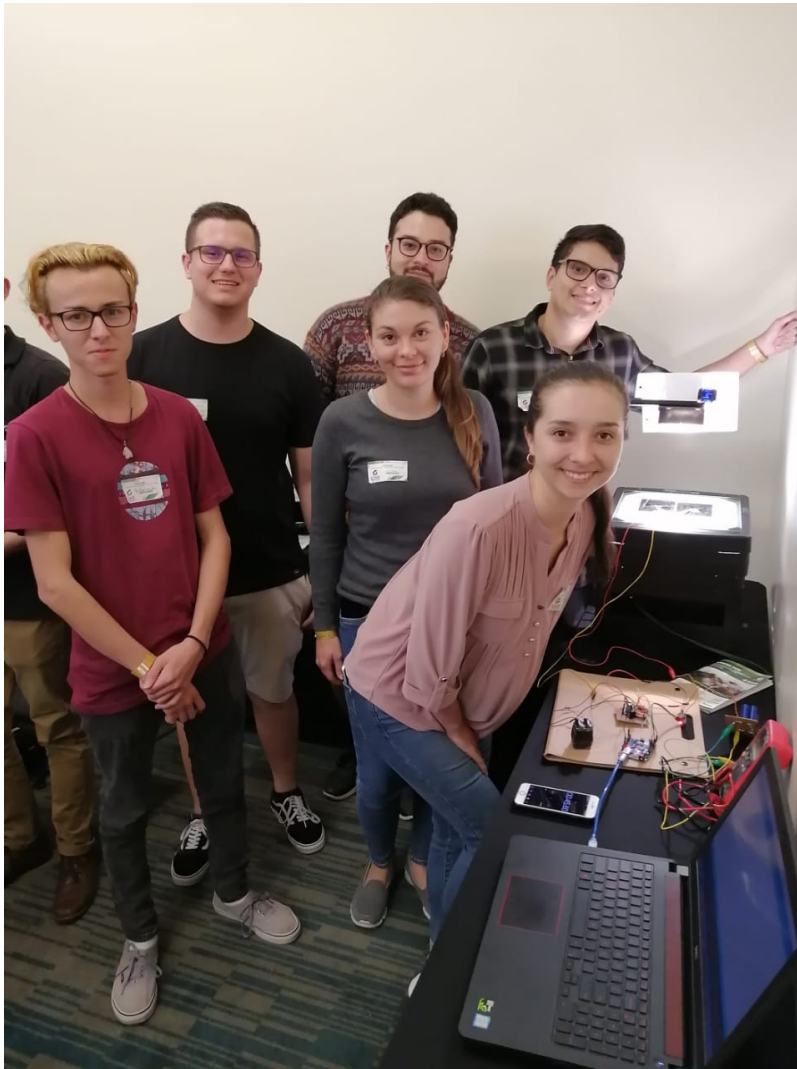
Se está desarrollando la próxima generación de talento, y la industria puede comentar los problemas que está viendo en el campo, y así guiar a las universidades en la búsqueda de soluciones más reales y aplicadas”, comentó Vida Ilderem, vicepresidenta de Intel Labs.

Ilderem presentó una de las charlas principales, sobre el futuro de la red 5G y cómo esto revolucionará el mundo, ampliando las capacidades de comunicación y conexión a niveles aún insospechados.

## **Alto nivel técnico**

Para los asistentes, lo más destacado del Lascas número 11 fue la **calidad de las charlas y el alto nivel de los presentadores.**

“Además de conocer aspectos técnicos a profundidad, en las presentaciones, aquí los estudiantes tienen la oportunidad de hacer contactos y conocer gente que es muy reconocida, con mucha experiencia en todas las áreas. Aparte de que también está presente la industria en el evento, así que tener contactos con personas que podrían ser sus futuros empleadores es muy importante”, comentó el Dr. Renato Rimolo Donadio, docente del TEC y uno de los organizadores del evento.



Como parte del Lascas, se desarrollaron talleres prácticos para estudiantes. Como este, que consistió en mover un tren eléctrico con paneles solares. **Foto: Cortesía Rama Estudiantil CAS.**

Para los estudiantes, en su mayoría del TEC, fue una gran oportunidad para conocer el nivel de desarrollo de la ingeniería en su más alto nivel y **establecer conexiones con investigadores de otras partes del mundo, así como con empresas líderes en el sector.**

Los alumnos también participaron en actividades prácticas y talleres, como la que organizó el Capítulo Estudiantil del CAS y que consistía en **poner a funcionar un pequeño tren eléctrico con paneles solares.**

“El taller se enfocó en la aplicación de algoritmos para la búsqueda del punto de máxima potencia de un sistema fotovoltaico y se ligó al concepto de un tren eléctrico”, detalló David Picado, vicepresidente del Capítulo Estudiantil CAS.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender del Dr. Carlos Meza en una sesión teórica y posteriormente poner a prueba sus algoritmos, poniendo en marcha un tren eléctrico a escala.

“Es importante abrir estos espacios de formación a estudiantes especialmente en temas de sostenibilidad y energías limpias, ya que son los que tienen en sus manos el futuro”

David Picado, Capítulo Estudiantil CAS

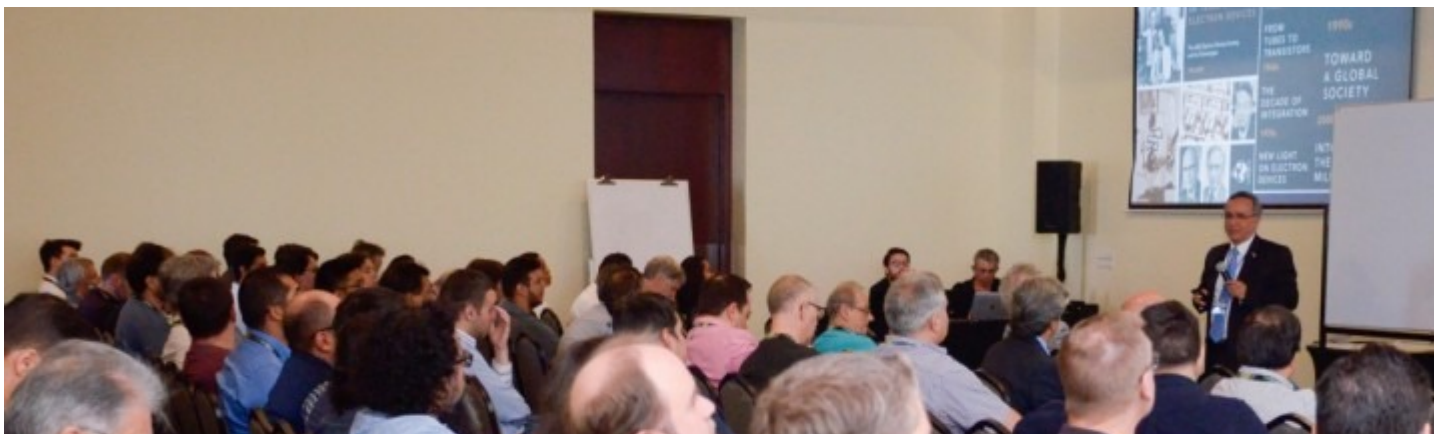
Para el Dr. Fernando Guarín, coordinador de la Electron Device Society (EDS) [19] –parte de la IEEE–, esta edición de **Lascas fue un éxito y un ejemplo para las próximas realizaciones del evento, que serán en Perú 2021 y Chile 2022.**

“Esto es muy importante para el ámbito de la región, que vean que en tecnología de punta y avanzada hay presencia latinoamericana. **En Latinoamérica hay talento y capital humano, así que es algo que estamos tratando de potenciar** con este tipo de congresos”, comentó Guarín



[20]

Como parte del evento, especialistas de diversas partes del mundo visitaron las instalaciones del TEC, el pasado 25 de febrero. **Foto: Ruth Garita / OCM.**



Inauguración de la sesión del miércoles 26 de febrero, Lascas 2020. **Foto: Ruth Garita.**



[22]

Estudiantes del TEC obtienen reconocimiento del máximo ente ingenieril a nivel mundial [22]

**Source URL (modified on 03/20/2020 - 11:03):** <https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/node/3501>

### Enlaces

[1] <https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/users/johan-umana-venegas>

[2] <http://www.ie.tec.ac.cr/lascas2020/>

[3] <https://www.ieee.org/>

[4] <https://www.tec.ac.cr/>

[5] <https://ieee-cas.org/>

[6] <https://www.intel.com/content/www/us/en/research/overview.html>

[7] <https://www.westerndigital.com/>

[8] <https://www.hpe.com/us/en/home.html>

[9] <http://www.mit.edu/>

[10] <https://www.asu.edu/>

[11] <https://home.www.upenn.edu/>

[12] <https://www.umd.edu/>

[13] <https://www.imperial.ac.uk/>

[14] <https://www.epfl.ch/en/>

[15] <http://www.universidad.edu.uy/>

[16] <http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial>

[17] <http://en.nagoya-u.ac.jp/>

[18] <https://carleton.ca/>

[19] <https://eds.ieee.org/>

[20]

[https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/sites/default/files/styles/colorbox/public/media/img/paragraph/lascas\\_2020\\_rgarita\\_01.jpg](https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/sites/default/files/styles/colorbox/public/media/img/paragraph/lascas_2020_rgarita_01.jpg)

[21]

[https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/sites/default/files/styles/colorbox/public/media/img/paragraph/lascas\\_2020\\_rgarita\\_05.jpg](https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/sites/default/files/styles/colorbox/public/media/img/paragraph/lascas_2020_rgarita_05.jpg)

[22] <https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2017/05/08/estudiantes-tec-obtienen-reconocimiento-maximo-ente-ingenieril-nivel-mundial>